

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-016

投资者关系活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他
参与单位名称及人员姓名	工银瑞信基金、国盛证券、财通证券
时间	2025 年 7 月 25 日 (周五) 上午 10:00-11:30 2025 年 7 月 25 日 (周五) 下午 15:00-16:30
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

投资者关系活动 主要内容介绍	1、如何看待公司企业级存储业务的增长空间？ 答：截止至今，公司系极少数能够在定期报告等信息披露文件正式披露具体企业级存储产品组合（eSSD 和 RDIMM）业绩的 A 股上市公司。从公开信息来看，公司也是国内少数具备“eSSD+RDIMM”产品设计、组合以及规模供应能力企业。2025 年，公司企业级存储产品组合继续取得突破，一季度实现收入 3.19 亿元，同比增长超 200%。 公司的企业级存储产品在自有核心知识产权、技术能力的基础上，已取得了不同行业知名客户的共同认可，客户涵盖中大型互联网企业、服务器企业、信创类企业以及运营商。这体现了公司企业级产品具有强大的适配性和可靠性，能够满足不同行业客户的高性能和定制化需求。随着 AI 应用不断加速，客户基于本地化、信息安全和供应安全等因素，也将会考虑更多地采用国产企业级存储产品，公司企业级业务有望在重要客户处持续取得突破。 2、公司为什么能和原厂达成 TCM 模式（技术合约模式）的合作？如何看待公司在存储产业的定位？ 答：公司与存储晶圆原厂达成 TCM 模式合作，是公司主控芯片、固件研发和封测制造等能力全面领先的集中体现。存储产品的性能、功耗和物理特性差异，取决于存储器厂商的技术积累与产品实现能力，这类能力源于长期在存储器层面的技术沉淀与工程经验积累，与存储晶圆的设计和制造分属产业链上下游的不同技术体系。公司在存储器环节各项技术上均处于行业领先水平，结合对市场需求的深刻理解和快速响应优势，能够差异化的满足其他厂商难以实现的高性能与定制化需求，从而区别于传统模组厂商，创造更高的技术和服务附加值。 凭借与行业头部客户的深度合作，公司将逐步发展为连接上游晶圆原厂与终端应用市场的重要桥梁，公司与闪迪的
---------------------------	---

	长期合作，正是公司技术实力与产业定位的有力体现。与产业上下游重要参与者的深度合作，将持续强化公司在存储生态中的独特地位，帮助公司获得超越传统存储器厂商的产业竞争地位。 3、公司 TCM 模式目前的开展情况？TCM 模式未来将如何影响公司的营收与利润？ 答：公司目前已与闪迪达成合作，基于江波龙与闪迪各自的领先能力，面向移动及 IOT 市场推出定制化的高品质 UFS 产品及解决方案。目前搭载公司自研主控芯片的 UFS4.1 产品，其顺序读写性能达到 4350MB/s 和 4200MB/s，随机读写性能达到 630K IOPS 和 750K IOPS，优于市场主流产品。依托公司 UFS 主控芯片的强劲性能，以及与晶圆原厂的深度合作，公司的 UFS 产品有望更大规模导入 Tier1 客户供应链中，进一步扩大公司在嵌入式存储市场的领先地位，提升公司在高端存储市场的市场占有率。 公司正积极推进 TCM 模式应用，依托于自身核心技术能力，拉通晶圆原厂与大客户，增加产业供应及需求双向能见度，一方面部分的降低价格波动产生的影响，另一方面让公司核心能力持续创造价值。除闪迪外，公司已与传音、ZTE 等 Tier1 客户，达成了 TCM 模式的合作，为 TCM 业务模式的拓展起到良好的示范性的效应，未来 TCM 业务模式将在主要大客户的合作上持续取得突破。 4、公司自研主控芯片的应用规模展望？ 答：公司自研主控聚焦于满足高端产品领域的客户需求，已推出了用于 eMMC、SD 卡、车规级 USB 产品的三款主控芯片，至今累计应用量已超过 3000 万颗，公司目前也已成功流片了首批 UFS 自研主控芯片。基于公司各系列主控芯片的工艺优势，搭载公司自研主控芯片的各类存储产品相较于市场同类产品具有明显的性能和功耗优势，公司将基于主控
--	--

	芯片技术实力，保持及扩大公司在存储各个市场的领先地位。在主控已实现规模应用的基础上，公司 2025 年全年的自研主控芯片应用规模预计实现明显放量增长。公司也将保持与第三方主控芯片厂商的长期合作，结合独立主控芯片厂商技术优势，拓宽自身产品组合，提供更多样化的存储解决方案。 5、如何看待三季度的存储价格走势？ 答：随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划，2025 年第一季度后半期存储产品的市场价格及各方心理预期均出现一定程度的上扬。持续三个季度的下游客户消化库存进程也基本结束，为满足自身生产销售的需要，下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息来看，半导体存储市场自 2025 年 3 月底开始逐步回暖。 根据闪存市场等独立第三方报告，受服务器 OEM 客户备库存需求，手机存储容量提升，以及存储晶圆原厂的价格策略影响，预计在第三季度，服务器和手机等领域的存储产品价格仍具上行动能。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无